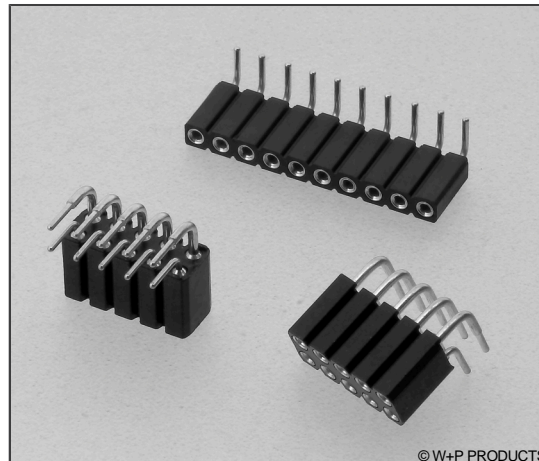


## Präzisions-Buchsenleisten RM 2,54mm, gewinkelt, 1-/2-reihig Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Right-Angled, Single/Double Row

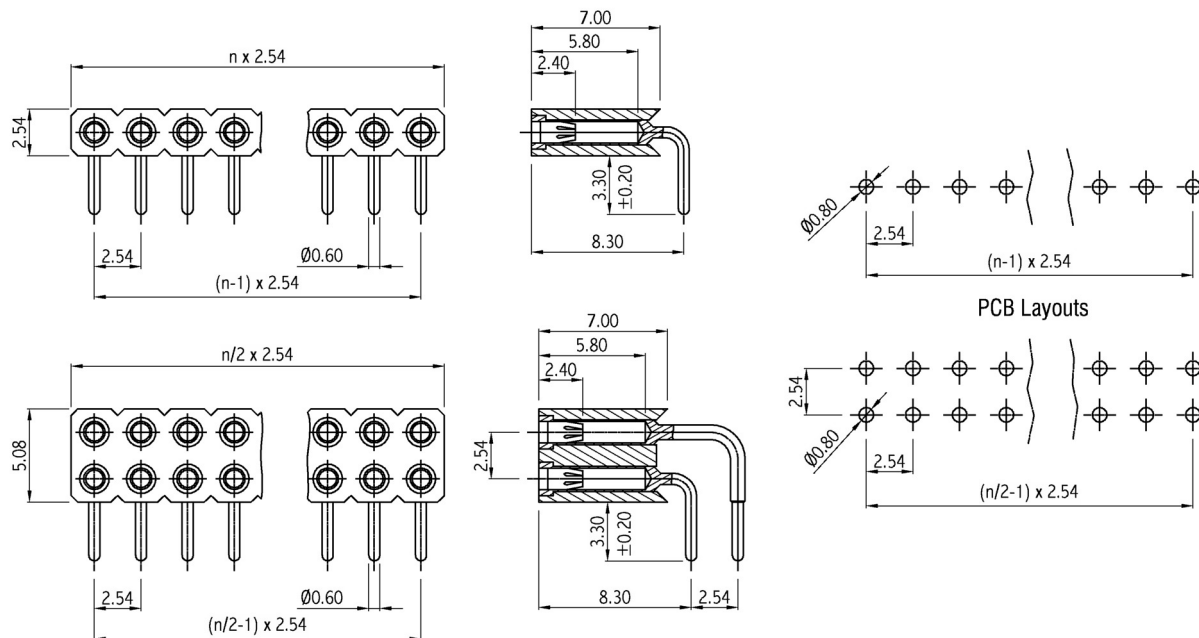
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Lamellen-Clip, Beryllium-Kupfer <i>Sleeve: screw machined brass Clip: 6-Finger-Clip, Beryllium-Copper</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 10 mΩ <i>&lt; 10 mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ <i>&gt; 1000 MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	1 kV RMS <i>1 kV RMS</i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	100 V RMS / 150 V DC <i>100 V RMS / 150 V DC</i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A <i>3 A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-55 °C ... +125 °C <i>-55 °C ... +125 °C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Einsetzbar für Rundstifte Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstifte 0,635mm. Auf Anfrage für Rundstifte Ø0,40-0,56mm oder Vierkantstifte 0,40x0,25mm erhältlich.  
Accept round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins.  
Also available on request for Ø0.40-0.56mm round pins or 0.40x0.25mm rectangular pins.



<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Rows*</b>	<b>Sleeve Plating</b>	<b>Clip Plating*</b>	<b>Leadfree (Optional)</b>
<b>154</b>	<b>002</b> 002-050 Einreihig Single row 004-100 Zweireihig Double row	<b>1</b> 1 Einreihig Single row 2 Zweireihig Double row	<b>50</b> 50 Hülse verzinkt Tin plated sleeve	<b>00</b> 00 Feder vergoldet Gold plated clip 10 Feder 0,25µm Gold (Option) 0.25µm gold plated clip (Option) 30 Feder 0,75µm Gold 0.75µm gold plated clip 50 Feder verzinkt Tin plated clip	<b>LF21</b> LF21 Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c (Nur einreihig) On request leadfree without RoHS exemption 6c (Single row only)

Für die einreihige Variante gilt eine Verarbeitungsgarantie bis 25-polig.  
For single row headers, we guarantee processing for up to 25 contacts.

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

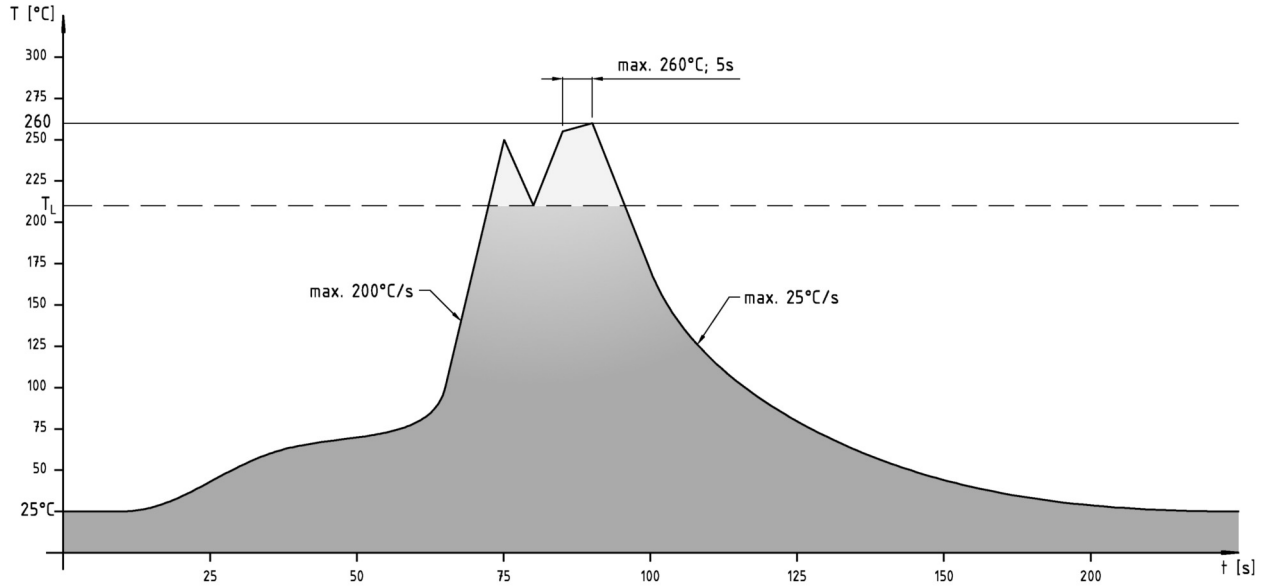
## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

